



邁向無所不在(Ubiquitous)的 新構裝材料技術紀元

根據工研院 IEK 的產業分析報告預估，2006 年全球電子構裝產業包括半導體構裝、硬質印刷電路基板及軟質印刷電路基板等產業，其總產值將達993億美元，其中構裝材料的相關產值即接近237億美元，顯示電子構裝產業隨著各電子產品不斷的推陳出新，在技術與市場上亦隨之快速成長。

我國電子構裝相關產業，在整體產值上不斷增加與成長，在全球電子產業之產品研發與製造體系中扮演著重要推手的角色；2006 年國內整體構裝產值預估將達158億美元，而包括半導體構裝材料、硬質印刷電路積層板材料與軟質印刷電路積層板材料在國內所創造的產值已達 50 億美元，佔全球構裝材料產值的 21% 左右，超越國內構裝產業在全球構裝產值中所佔的15%比例。由此點可看出，隨著業者的西進與產業體系的分工，電子構裝材料產業在我國未來電子產業的發展中將有更大的發展機會。

隨著電子產品朝無線傳輸、高頻數位化及無所不在(Ubiquitous)的設計技術需求，電子構裝技術發展亦面臨前所未有的嚴格挑戰，特別是在多功能產品整合、環保法規限制及低成本競爭的多重考量下，結合新材料與新產品設計製程的技術研發優勢，創造市場品牌與規範認證優勢，將是未來我國電子構裝產業發展在藍海競爭策略中最關鍵的一環。因此，在本次新世代電子構裝材料技術專題中，特別針對國內電子構裝技術未來發展所需構裝材料技術與趨勢作介紹與說明，期能提供作為國內電子構裝業者在設計、製程與材料研發上的參考，進而開創新契機。■

王中明